

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 关于制定《员工购房借款管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● **基本情况：**为帮助有购房需求的员工减轻购房负担，更好地吸引优秀人才和留住关键人才，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总金额不超过 2,000 万元的自有资金设立借款资金池，为符合特定条件的员工提供购房借款，在此限额内资金额度可循环使用。借款年利率原则上为 1%，由公司结合员工的工作年限、贡献程度以及实际情况等最终确定。购房借款期限最长不超过 5 年。

● **履行的审议程序：**本事项已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● **风险提示：**公司能够对员工借款的资格、条件、借款额度等方面实施有效的风险控制，设定了一系列的内控监督措施以保证资金的安全，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、财务资助事项概述

为帮助有购房需求的员工减轻购房负担，更好地吸引优秀人才和留住关键人才，公司拟使用总金额不超过 2,000 万元的自有资金设立借款资金池，为符合特定条件的员工提供购房借款，在此限额内资金额度可循环使用。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，确保不损害公司及股东的利益，公司拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司员工购房借款管理制度》。

公司第二届董事会审计委员会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》；第二

届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》；第二届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对员工借款的资格、条件、借款额度等方面实施有效的风险控制，设定了一系列的内控监督措施以保证资金的安全。

## 二、被资助对象的基本情况

（一）被财务资助对象为公司及其下属公司（包括：分公司、全资子公司、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体，不含境外公司）的所有符合管理制度申请条件的员工。

（二）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员，以及与前述主体关系密切的家庭成员等关联人除外。

## 三、《员工购房借款管理制度》的主要内容

（一）借款对象：公司及其下属公司（包括：分公司、全资子公司、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体，不含境外公司）的所有符合管理制度及公司相关规章制度中申请条件的员工。

（二）借款资格：员工与公司、下属公司建立劳动关系且已连续工作满两年（含）及以上，申请借款前，员工工作表现良好，之前年度个人绩效及岗位符合公司要求，无任何违纪处分记录。员工为所购住房的所有权人之一。员工及其配偶（如有）无不良征信记录（如有过连续或信用卡恶意透支记录被银行列入黑名单的，需自记录消除之日起满 5 年），且未被人民法院列为失信被执行人。

（三）借款用途：用于员工在工作地或公司认可的其他所在地购买其自用商品房（不含商铺、自建房和宅基地）。不适用于以投资为目的的购房行为。

（四）员工借款额度：员工购房借款实际批准金额原则上不超过该员工上一年度税前年薪的 2 倍且不超过人民币 100 万元（具体借款额度由公司结合借款员

工的服务年限、偿还能力、薪资水平、绩效表现等因素审批确定)。针对个别有借款金额超过人民币 100 万元需求的员工,可经公司管理层讨论,总经理特别批准后享受较高的借款金额,但单个员工借款金额上限不超过上一年度税前年薪的 2 倍且不超过人民币 200 万元。

(五) 借款期限: 员工购房借款期限最长不超过 5 年(即不超过 60 个月)在此范围内由员工提出申请。

(六) 借款利息: 借款年利率原则上为 1%, 公司结合员工的工作年限、贡献程度以及实际情况等最终确定。自借款之日起,若半年度绩效考核不符合公司相关要求,公司可要求员工提前全额还款或在下一次还款期按照银行同期贷款基准利率计算利息。如后续半年度绩效考核符合公司相关要求,下一个还款期恢复借款 1%的借款利息。

(七) 还款方式: 员工必须在借款协议约定的借款期内偿还全部借款本金及利息,具体还款方式于《员工购房借款合同》中约定。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

公司制定了《员工购房借款管理制度》,明确了借款流程和风险防范措施,整体风险可控:

(一) 《员工购房借款管理制度》对员工借款的资格、条件、借款额度等进行了具体规定。

(二) 借款员工从公司获得的持股平台份额及/或股权激励,应在获得分红及减持收益后优先用于对借款的偿还。

(三) 公司各部门负责人严格审核部门员工提交的申请资料,并配合人事行政部和财务部了解、监督员工对借款的使用、归还进度情况。若发现部门负责人有隐瞒、包庇行为,公司将按照内部管理制度对相关责任人予以追责。

(四) 公司人事行政部有权于每个年度结束后的三个月内,对员工的住房借款使用情况和住房产权状况进行核查,以确保员工购房用于自住,产权仍在员工名下。财务部应于每个年度结束后的三个月内,编制员工购房借款情况总结报告,内容包括但不限于借款人名单、借款情况、收款情况等。

#### **五、董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。

经审议，董事会认为：本次财务资助事项，是公司为帮助有购房需求的员工减轻购房负担，更好地吸引优秀人才和留住关键人才。在不影响公司主营业务发展的前提下，董事会同意公司制定的《员工购房借款管理制度》，同意公司使用总金额不超过人民币 2,000 万元的自有资金设立借款资金池，为符合特定条件的员工提供购房借款。《员工购房借款管理制度》的制定符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会一致同意公司向员工购房提供借款并制定《员工购房借款管理制度》。

#### **六、累计提供财务资助金额及逾期金额**

《公司员工购房借款管理制度》生效后，公司对员工购房借款总额度为 2,000 万元人民币，占 2023 年末公司经审计净资产总额的 1.43%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日